**《附件2》利用個人資料告知事項暨提供同意書**

**數位發展部數位產業署**

**蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書**

**數位發展部數位產業署**委託計畫執行單位-台北市電腦商業同業公會辦理「AI產業生態暨多元人才賦能推動計畫」 (以下簡稱本計畫)，因應個人資料保護法及相關個人資料保護規定，在向您蒐集個人資料之前，依法向您告知下列事項，當您本人親筆簽名後，表示您已閱讀、瞭解並同意接受本同意書之所有內容：

1. 蒐集目的及類別

為本計畫相關執行/辦理所涉行政管理、申請作業管理、通知聯繫、活動訊息發布、相關統計分析之蒐集目的，而須獲取您下列個人資料類別：姓名、性別、職稱、部門、經歷、電話、手機及電子郵件。

1. 個人資料利用之期間、地區、對象及方式

您的個人資料，除涉及國際業務或活動外，將提供本機關(構)於中華民國領域，於上述蒐集目的之必要合理範圍內加以利用至前述蒐集目的消失為止。

1. 當事人權利行使

依據個人資料保護法第3條，您可向計畫執行單位請求查詢或閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集/處理/利用或刪除您的個人資料。

1. 不提供個人資料之權益影響

如您不提供或未提供正確之個人資料，或要求停止蒐集/處理/利用/刪除個人資料、服務訊息的取消訂閱，本機關(構)將無法為您提供蒐集目的之相關服務。

1. 各項通知服務、相關訊息之停止寄送，可透過訊息內容提供之取消訂閱連結通知。您可於上班時間聯繫計畫執行單位承辦人林小姐（電話(02)2570-6337，分機：9865）。就違反本個資聲明事項之行為，請與執行單位承辦人反映。

**個人資料同意提供：**

1. 本人確已閱讀並瞭解上述告知事項，並勾選「我同意」授權貴機關(構)於所列目的之必要合理範圍內，蒐集、處理及利用本人之個人資料。
2. 本人瞭解此同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，並同意提供予貴機關(構)留存及日後查證使用。

🞏我同意 🞏我不同意

立同意書人：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 團隊  成員 |  | 姓名  (請清楚填寫或繕打) | 簽名  我已完整閱讀且同意上開蒐集個人資料告知提供(須由本人簽名) |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

請用印公司大章

請用印

負責人章

中華民國114年　　月　　日